

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

## 上海盛剑科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表（2024年半年度业绩说明会）

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
2024年半年度业绩说明会召开的基本情况	1、会议召开时间：2024年9月6日下午14:00-15:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理张伟明先生，独立董事封薛明先生，董事、副总经理、董事会秘书聂磊先生，财务负责人郁洪伟先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>在本次业绩说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行了梳理，主要问题及答复如下：</p> <p><b>1、公司存货金额较上年期末增长较多的原因？</b></p> <p>截至2024年6月30日，公司存货金额为8.87亿元，较2023年期末增长35.38%，主要为在执行项目中已完成生产但尚未移交给客户的部分产品，随着后续完成交付或现场安装调试，可实现对应当期项目收入的转化。</p> <p><b>2、合同负债金额较往期显著增加的原因？</b></p> <p>截至6月底，公司合同负债金额为1.41亿元，较上年期末增长31.19%。主要是因为公司积极加大市场开拓力度，部分项目的预收</p>

款项在合同负债科目进行核算。

### **3、上半年公司厂务系统业务毛利率提升的原因？**

公司绿色厂务系统业务包括半导体工艺废气系统、化学品供应与回收系统两部分。今年上半年该业务毛利率有所提升主要受益于以下三大方面：1) 公司在项目体量较大、业务集中度较高的地区完成如华南生产基地、华中生产基地的属地化配套并投产，提升经营效率；2) 随着产能的不断提升，规模效应同步释放，同时加强精细化管理及提高部分关键物料的自产化率，有效降低经营成本；3) 产品结构及技术方案不断优化，伴随着行业头部客户业绩积累，行业核心竞争力在增强。

### **4、近年来在股东回报方面，公司有何举措？**

自上市以来，公司高度重视股东回报，积极实施现金分红并开展回购。(1) 2020、2021、2022、2023 年度现金分红（含税）和股份回购金额合计占归属于上市公司股东的净利润的比例分别为 30.06%、30.06%、76.43%、20.20%。(2) 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司和股东利益，切实履行社会责任，落实“提质增效重回报”行动方案，积极践行投资者回报并加强投资者交流，树立良好资本市场形象；同时，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的判断，为建立、健全长效激励机制，充分调动员工的积极性，促进公司健康可持续发展，2024年2月推出新一轮股份回购方案，拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。目前该方案正在实施中。

### **5、公司 L/S 设备在存储芯片客户的业务开拓怎么样了？**

公司积极推进等离子+水洗双腔机型在某存储芯片头部客户 Etch 工艺端的应用验证。该机型能够满足客户对设备小型化、绿色节能、超低排放等技术需求，目前在积极推动测试订单转化及跟进后续批量性订单。

### **6、请详细介绍公司上半年在三大业务板块的进展情况？**

公司始终围绕“为科技企业提供绿色服务，为绿色企业提供科技产品”的战略定位，聚焦集成电路、半导体显示、新能源三大高新技术产业市场机遇。1) 在半导体显示领域，密切跟踪行业新技术研发、新项目投资节奏，上半年承接、交付了一批重点项目，展现了稳固的竞争优势；2) 在集成电路领域，加强与行业重点客户的合作，为客户提供有针对性的解决方案，行业市占率、影响力稳步提升；3) 在新能源领域，不断深化产品与服务的嫁接应用，助力新能源产业生产率的优化。报告期内，公司在以上三大先进制造业实现收入 66,028.13 万元，其中源自集成电路、半导体显示领域营收占主营业务比重达 87.78%，进一步夯实了在高科技制造产业绿色科技领域的领先地位。

#### **7、公司半导体装备和零部件业务有什么新进展吗？**

2024 年上半年，公司发布真空设备、温控设备、Local Scrubber 新产品，为下游客户提供更多自主设备选择。Local Scrubber 完成燃烧+水洗双腔机型的研发及内部测试，可覆盖半导体多个工艺段的应用场景；积极响应客户对设备小型化、绿色节能、超低排放等技术需求，推进等离子+水洗双腔机型在某存储芯片头部客户 Etch 工艺端的应用验证及订单转化，该机型在处理半导体含氟化物等方面具备优势；启动针对减压外延工艺的 Local Scrubber+真空泵一体机开发立项。

#### **8、公司半导体装备和零部件这块业务规划在产品选择上是如何考虑的？**

半导体附属装备及核心零部件作为公司的核心战略业务之一，公司围绕该领域逐步完成了工艺废气处理设备、真空设备和温控设备的国产化研制。上述设备共同作用于对半导体制程设备反应腔的辅助控制，可使反应腔满足刻蚀、离子注入、扩散及薄膜沉积等工艺所需的环境条件，是半导体附属装备及核心零部件中不可或缺的重要组成部分。

注：本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承

	诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。
其他事项	关于公司 2024 年半年度业绩说明会的召开情况及主要内容，投资者可登陆上证路演中心（ <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ）进行查看。公司在此，对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！后续欢迎大家继续通过投资者热线、邮件、上交所 e 互动平台等方式与公司进行交流。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 9 月 9 日